

Repair Stick Kupfer

Artikel Nr. 114584

Typen Nr. 115.31



Versand in die Schweiz nicht möglich!

Beispielhafte Darstellung

Für sehr schnelle (3 Minuten) Reparaturen von Rissen, Leckagen und Undichtigkeiten auch auf feuchten und nassen Flächen wie Rohre, Rohrbögen, Fittings, Flansche, Kupferbleche, Tanks, Gefrier- und Klimaanlage und als Reparaturmasse für die Installation und das Handwerk.

Technische Informationen

Gebindegröße	57 g
GHS	GHS07 GHS09
GHSSIGNAL	A
Gefahrenhinweis	H315 - Verursacht Hautreizungen. H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 - Verursacht schwere Augenreizung. H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Basis	Epoxid
Füllstoff	Kupfer
Konsistenz	Knetmasse
Farbe	kupferfarben
Verarbeitungstemperatur	15 bis 40 °C
Bauteiltemperatur	> 3 °C über Taupunkt
Aushärtetemperatur	6 bis 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	<85 %
Mischungsverhältnis nach dem Gewicht	1:1
Dichte der Mischung	1,9 g/cm ³
Spaltüberbrückung bis max.	15,0 mm
Topfzeit (bei 20 °C, 10 g Ansatz)	4-5 min
Handfestigkeit (35 % der Festigkeit)	10 min
Mechanisch belastbar nach (80 % der Festigkeit)	60 min
Endhärte (100% der Festigkeit)	24 Stunden
Schrumpf	< 1,0 %
Druckfestigkeit DIN EN ISO 604	55 MPa
Härte (Shore D) DIN ISO 7619	82±3

Technische Informationen

Haftfestigkeit DIN EN ISO 4624	7 MPa
Temperaturbeständigkeit	-50 bis 120 °C
Temperaturbeständigkeit kurzzeitig	150 °C
Wärmeleitfähigkeit DIN EN ISO 22007-4	0,7 W/m·K
Durchgangswiderstand DIN EN 62631-3-1	ca. $5 \cdot 10^{11} \Omega \cdot m$
Elektrischer Widerstand ASTM D 257	5 $\Omega \cdot cm$
Durchschlagsfestigkeit	3,0 kV/mm
Magnetisch	nein

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	32141010
Ursprungsland	DE
eCl@ss 5.1.4	30021609
eCl@ss 9.0	30021609
UNSPSC_Code_v190501	47131825
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Contact surface cleaners

Material Informationen

REACH SVHC1 Stoff Name	no
CAS-Nr. SVHC 1	no CAS No.
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
REACH Info	no SVHC substance included

Umrechnungstabelle

(°C x 1,8) + 32	=	°F
mm/25,4	=	inch
$\mu m/25,4$	=	mil
N x 0,225	=	lb
$N/mm^2 \times 145$	=	psi
MPa x 145	=	psi
Nm x 8,851	=	lb·in
Nm x 0,738	=	lb·ft
Nm x 141,62	=	oz·in
mPa·s	=	cP
N/cm x 0,571	=	lb/in
kV/mm x 25,4	=	V/mil

Produktinformationen

Sehr schnellhärtend | kupfergefüllt

Repair Stick Kupfer eignet sich für sehr schnelle Reparaturen und Ausbesserungen von Rissen, Leckagen und Undichtigkeiten. Das Epoxidharz-System hat eine sehr schnelle Verarbeitungszeit von nur drei Minuten und kann auch auf feuchten und nassen Flächen eingesetzt werden. Mit dem Stick lassen sich Rohre und Rohrbögen, Fittings und Flansche, Kupferrinnen und -bleche, Wassererhitzer, Wassertanks, Warm- und Kaltwasserleitungen und Gefrier- und Klimaanlage schnell und unkompliziert reparieren und ausbessern. Repair Stick Kupfer kann im Behälter- und Apparatebau, in der Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharmaindustrie und in vielen anderen Bereichen zum Einsatz kommen.

Gebrauchshinweise

Bei der Verarbeitung von RIEGLER Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EG Sicherheitsdatenblättern (www.riegler.de) zu beachten.

Oberflächenvorbehandlung

Voraussetzung für eine einwandfreie Haftung sind saubere und trockene Oberflächen.

Verarbeitung

Repair Sticks Kupfer überbrücken pro Arbeitsgang einen Klebespalt bis max. 15 mm. Die angegebene Topfzeit bezieht sich auf einen Materialansatz von 25 g bei Raumtemperatur. Bei größeren Ansatzmengen erfolgt, bedingt durch die typische Reaktionswärme von Epoxidharzen (exotherme Reaktion) eine schnellere Aushärtung. Höhere Temperaturen verkürzen ebenfalls die Topf- und Aushärtezeit. (Faustregel: je +10 °C Erhöhung über Raumtemperatur - führt zu einer Verkürzung der Topf- und Aushärtezeit um die Hälfte). Temperaturen unter +16 °C verlängern Topf- und Aushärtezeit erheblich. Ab ca. +5 °C erfolgt keine Reaktion mehr.

Lagerung

Repair Sticks Kupfer sind im ungeöffneten Zustand bei konstanter Raumtemperatur von ca. +20 °C und trockener Lagerung mindestens 18 Monate haltbar. Sonnenbestrahlung vermeiden.

Repair Stick Kupfer

Chemische Beständigkeit von Repair Stick Kupfer nach der Aushärtung* (Auszug)

Abgase	+	Kaliumcarbonat (Pottaschelösung)	+
Aceton	o	Kaliumhydroxid 0-20 % (Ätzkali)	+
Aethylaether	+	Kalkmilch	+
Aethylalkohol	o	Karbolsäure (Phenol)	-
Aethylbenzol	-	Kreosotöl	-
Alkalien (basische Stoffe)	+	Kresylsäure	-
Kohlenwasserstoffe, aliphatische (Erdölabbkömmlinge)	+	Magnesiumhydroxid	+
Ameisensäure >10 % (Methansäure)	-	Maleinsäure (cis-Ethylendicarbonsäure)	+
Ammoniak wasserfrei 25%	+	Methanol (Methylalkohol) <85 %	-
Amylacetat	+	Mineralöle	+
Amylalkohole	+	Naphtalin	-
Kohlenwasserstoffe, aromatische (Benzol, Toluol, Xylol)	+	Naphtene	-
Bariumhydroxid	+	Natriumcarbonat (Soda)	+
Benzine (92-100 Oktan)	+	Natriumbicarbonat (Natriumhydrogencarbonat)	+
Bromwasserstoffsäure <10 %	+	Natriumchlorid (Speisesalz)	+
Butylacetat	+	Natriumhydroxid >20 % (Ätznatron)	o
Butylalkohol	+	Natronlauge	+
Calciumhydroxid (gelöschter Kalk)	+	Heizöl, Diesel	+
Chloressigsäure	-	Oxalsäure <25 % (Ethandisäure)	+
Chloroform ((Trichlormethan)	o	Perchloraethylen	o
Chlorschwefelsäure (nass und trocken)	-	Petroleum	+
Chlorwasser (Schwimmbadkonzentration)	+	Oele, pflanzliche und tierische	+
Chlorwasserstoffsäure 10-20 %	+	Phosphorsäure <5 %	+
Chromierungsbäder	+	Phthalsäure, Phthalsäureanhydrid	+
Chromsäure	+	Rohöl	+
Dieselmotorenstoffe	+	Salpetersäure <5 %	o
Erdöl- und Erdölprodukte	+	Salzsäure <10 %	+
Essigsäure verdünnt <5 %	+	Schwefeldioxid (feucht und trocken)	+
Ethanol <85 % (Ethylalkohol)	+	Schwefelkohlenstoff	+
Fette, Öle und Wachse	+	Schwefelsäure <5 %	o
Fluorwasserstoffsäure verdünnt (Flusssäure)	o	Testbenzin	+
Gerbsäure verdünnt <7 %	+	Tetrachlorkohlenstoff (Tetrachlormethan)	+
Glycerin (Trihydroxypropan)	+	Tetralin (Tetrahydronaphthalin)	o
Glykol	o	Toluol	-
Huminsäure	+	Wasserstoffperoxid <30 % (Wasserstoffsuperoxid)	+
Imprägnieröle	+	Trichloraethylen	o
Kalilauge	+	Xylol (Xylen)	-

+ = beständig 0 = zeitlich begrenzt - = unbeständig *Die Einlagerung aller Repair Sticks erfolgte bei +20°C Chemikaliientemperatur.